

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-049

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景 23 转债”）1,154.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 115,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,438.46 万元，募集资金净额为 113,961.54 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，“景 23 转债”募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	实施主体	项目投资额	拟以募集资金投入	项目已投入金额		剩余可使用募集资金金额（含存款利息）
				非募集资金已投入金额	募集资金已投入金额（含存款利息）	
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目	景旺电子科技（珠海）有限公司	258,715.43	115,400.00	130,367.08	80,304.44	35,671.55
合计		258,715.43	115,400.00	130,367.08	80,304.44	35,671.55

截至 2025 年 4 月 30 日，“景 23 转债”募集资金在专用账户的存储情况如下：

单位：万元

募集资金专用账户名称	开户行	银行账号	账户余额
深圳市景旺电子股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳南头支行	758876863706	14,298.50
景旺电子科技（珠海）有限公司	中国银行股份有限公司深圳南头支行	745876866588	1,373.06
合计		-	15,671.55

注：上述余额不包含本次闲置募集资金临时补充流动资金的 20,000.00 万元。

因此，按照已投入资金额占总投资的比例来计算项目完工进度，本次募投项目的项目完工进度已达 81.43%且已部分投产，目前仍在持续投入建设，逐步增加项目产能。

上述剩余可使用募集资金金额将继续用于支付尚未支付完毕的已实施工程设备合同尾款以及购置本次募投项目所需的工程设备。

三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的情况

截至 2025 年 4 月 30 日，“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年

产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目”（以下简称“HDI 项目”）累计投资金额为人民币 210,671.52 万元，其中以募集资金投入金额为人民币 80,304.44 万元、自有资金投入金额为人民币 130,367.08 万元，累计投资额占该项目承诺投资总额的 81.43%。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目全部建成时间进行调整。具体如下：

项目名称	变更前预计达到预定可使用状态日期	变更后预计达到预定可使用状态日期
景旺电子科技（珠海）有限公司 一期工程——年产 60 万平方米 高密度互连印刷电路板项目	2025 年 6 月	2026 年 6 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司 HDI 项目采用边建设边投产的方式，原计划工程建设期 4.5 年，于 2019 年第四季度开始建设，已于 2021 年 6 月部分投产，本项目达产后，将形成 60 万平方米的 HDI 板（含 mSAP 技术）生产能力。公司募投项目的投资规划形成时间较早，基于公司稳健经营的理念，在募投项目实施过程中，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，避免产能过早投入形成浪费，公司谨慎考虑了宏观经济环境、行业发展情况以及公司实际情况，适时控制投资节奏，减缓了 HDI 项目的建设实施进度，使 HDI 项目全部建成时间有所延后。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目全部建成时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。

高阶 HDI 产品可广泛应用于 AI 服务器及数据中心、光模块、汽车智驾、高端消费电子等领域，其庞大的市场需求及广泛的下游应用领域为公司本项目的实施提供了良好的市场基础。公司本次实施的募投项目与公司未来经营战略方向、市场需求发展趋势一致，募投项目的成功实施将进一步扩大公司高端产能和经营规模，增强公司竞争力，从而巩固并提升公司市场地位，推动公司高质量发展。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率和未来收益。

五、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将 HDI 项目全部建成时间延期至 2026 年 6 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将 HDI 项目全部建成时间延期至 2026 年 6 月。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议等会议资料，经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日